



EVG[®]770 NT

ステップ&リピート・ナノインプリント ・リソグラフィ装置



イントロダクション

優れたマスター製造を担うステップ&リピート・ナノインプリント・リソグラフィ

EVG770 NTは複雑な構造 / 超微細パターンの効率的マスター製造、また直接パターンニング向けのステップ&リピート(S&R)・ナノインプリント・リソグラフィプロセスに幅広く使用されるプラットフォームです。この装置では最大30cm²までの小さなダイを基に均一に複製したテンプレートを作製することができます。S&Rプロセスは、Gen2パネルサイズまでの基板に対応し、これらのダイを広範囲にわたってパターンニングすることを可能にしています。S&Rインプリンティングは、ウェーハレベル・オプティクス(WLO)やEVGのSmartNILプロセスに必要なマスターを効率的に製造するために、ダイヤモンドターニングや直描方式で作製された原版と組み合わせて使用されています。このプロセスは、近年ではAR(拡張現実)用の導波路、光センサー、回析光学、メタサーフェス、そしてバイオメディカル向けのデバイス作製にとって、非常に重要な技術となっています。

EVG770 NTは、高精度位置合わせ機能、緻密なプロセスパラメータ制御など、さまざまなパターン構造や材料に対応する幅広い機能が備わっています。

技術データ	
対応基板サイズ	80 mm, 4", 6", 8", 12", Gen2 (370 mm x 470 mm)
ダイ・トゥ・ダイ配置精度	< +/- 1 μm
ライブアライメント	< +/- 250 nm
最大テンプレート寸法	80 mm x 80 mm
有効インプリント範囲	30 cm ²
LED 露光波長	365 nm
露光強度	> 300 mW/cm ²
レジスト粘度対応範囲	100-10000 cp
デイスパンスシステム対応各種材料	IPA, PGMEA, MEK, Acetone

お問い合わせ

イーヴィグループジャパン株式会社
〒240-0005
神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134
横浜ビジネスパークウエストタワー1F
+81 45 348 0665



特長

- WLO用のマイクロレンズから、SmartNIL[®]向けのナノ構造に至るまでの最高品質のマスター製造
- パネルサイズまでのより大きな基板サイズへの展開
- マスターの容易な段取り替え
- 各種レジスト滴下モード
- レジスト滴下、インプリント、離型プロセス時のライブ画像
- インプリンティング力と離型力のin-situ制御
- 光学距離制御と即時ギャップ測定
- オプションによるインライン測定
- オプション搭載可能なスタンプバッファと自動交換機能
- カセット・トゥ・カセット自動搬送オプション

Printed on paper from sustainable sources. Data, design and specifications may not simultaneously apply or depend on individual equipment configuration, process conditions and materials and may vary accordingly. EVG reserves the right to change data, design and specifications without prior notice. All trademarks, logos, website addresses or equipment names are registered trademarks and/or the property of EV Group or their respective owners. © EV Group (EVG). All rights reserved. V21/01 JP based on V21/01

